

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 20 年 11 月 27 日 (2008.11.27)

【公開番号】特開 2007-115954 (P2007-115954A)

【公開日】平成 19 年 5 月 10 日 (2007.5.10)

【年通号数】公開・登録公報 2007-017

【出願番号】特願 2005-306929 (P2005-306929)

【国際特許分類】

H 0 5 K 3/46 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 3/46 N

H 0 5 K 3/46 G

【手続補正書】

【提出日】平成 20 年 10 月 10 日 (2008.10.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

少なくとも 3 層の絶縁層を有し、表層から数えて 2 層目に形成された 2 層目絶縁層は、それを貫通する電氣的接続が導電性ペーストであるペースト接続層となっており、表層から数えて 1 層目に形成された 1 層目配線と、表層から数えて 3 層目に形成された 3 層目配線とが、前記ペースト接続層を貫通するスキップビアで電氣的に接続され、表層から数えて 2 層目に形成された 2 層目配線と、表層から 3 層目に形成された 3 層目配線とが前記ペースト接続層に埋設されていることを特徴とする多層プリント配線基板であって、前記ペースト接続層は、繊維を含むプリプレグと前記プリプレグに形成された貫通孔に充填された導電性ペーストとからなる多層プリント配線基板。

【請求項 2】

樹脂フィルムからなる表層から数えて 1 層目の 1 層目絶縁層と、前記 1 層目絶縁層表面に接着剤を介することなく形成された配線と、を有する請求項 1 に記載の多層プリント配線基板。

【請求項 3】

絶縁基材に貫通孔を加工する孔加工工程と、
前記貫通孔に導電性ペーストを充填してペースト接続層を形成するペースト接続層形成工程と、
両面基板を作成する両面基板作成工程と、
前記ペースト接続層の表裏面に前記両面基板を積層する積層工程と、
前記積層体を熱プレス加工する熱プレス工程と、
を少なくとも備えた多層プリント配線基板の製造方法。

【請求項 4】

前記層間接続形成工程は、
少なくともスキップビア穴を形成する孔加工工程と、
前記スキップビア穴にめっきを施すめっき工程と、
からなる請求項 3 に記載の多層プリント配線基板の製造方法。